



山东宝乘电子有限公司

可靠性试验表(参考)

序号	试验项目 (Test Item)	试验条件 (Condition)	参考标准 (Reference)	实验时间 (Time)	适用范围 (Scope)
1	高温反偏 (High Temperature Reverse Bias)	① $T_A=150\pm5\text{ }^{\circ}\text{C}$ for GPP ② $T_A=100\pm5\text{ }^{\circ}\text{C}$ for SKY Bias=80% V_R	MIL-STD-750F METHOD-1038	168 Hrs	All Series 所有系列
2	高温高湿 (High-temperature High-humidity storage test)	$T_a=85\text{ }^{\circ}\text{C}$ RH=85%	MIL-STD-202F METHOD-103B	168 Hrs	All Series 所有系列
3	高温储存 (High Temperature Storage)	$150\text{ }^{\circ}\text{C}$ (+10, -0)	MIL-STD-750F METHOD-1031	168 Hrs	All Series 所有系列
4	高压蒸煮 (Auto-clave)	$T_A=121\pm2\text{ }^{\circ}\text{C}$, P=29.7Psia or 205KPa, RH=100%	JESD22-A102D	24 Hrs	All Series 所有系列
5	可焊性试验 (Solderability)	$245\pm5\text{ }^{\circ}\text{C}$	MIL-STD-750F METHOD-2026	10 Sec	All Series 所有系列
6	耐焊接热 (Resistance to solder heat)	$260\pm5\text{ }^{\circ}\text{C}$	MIL-STD-750F METHOD-2031	10 Sec	All Series 所有系列
7	正向浪涌试验 (Forward Surge Test)	8.3ms, Single, Half-Wave	MIL-STD-750F METHOD-4066	1 Pulse	All Series 所有系列
8	静电测试 (ESD)	IEC61000-4-2: Gpp芯片4kV; 肖 特基芯片: 6kV	AEC-Q101-001/002	1 Cycle	All Series 所有系列